

**IEC 60191-6-18**  
(Edition 1.0 – 2010)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF  
SEMICONDUCTOR DEVICES –**

**Part 6-18: General rules for the preparation of  
outline drawings of surface mounted  
semiconductor device packages –  
Design guide for ball grid array (BGA)**

**CEI 60191-6-18**  
(édition 1.0 – 2010)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS  
À SEMICONDUCTEURS –**

**Partie 6-18: Règles générales pour la préparation  
des dessins d'encombrement des dispositifs à  
semiconducteurs pour montage en surface –  
Guide de conception pour les boîtiers matriciels  
à billes (BGA)**

## **CORRIGENDUM 2**

**3.1**  
**ball grid array**  
**BGA**

*This correction applies to the French only.*

**3.1**  
**boîtier matriciel à billes**  
**BGA**

*Remplacer la note existante par la  
nouvelle note qui suit:*

NOTE Dans la présente norme, BGA signifie  
« Boîtier matriciel à billes », nom conforme  
aux normes existantes (Voir Bibliographie).